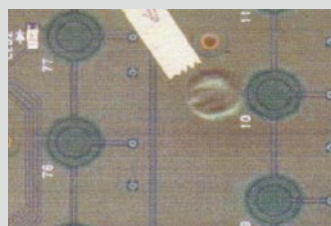


【原因、判断要点、发生工序】原因不明，有时是热应力引起分层（加热工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The cause is unknown. Thermal stress may cause the blisters. (Heating process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

7-4-29 FPC ベース面打痕／FPC 基底有压痕／Dent on FPC base material surface

【特徴】FPCのベース面に打痕が認められる状態の欠陥

【特征】FPC 基底有压痕的缺陷，

【Characteristics】The base material surface of an FPC is dented.

【原因・判断ポイント・発生工程】カバーレイ貼り付けプレス、または打ち抜きプレス時に異物が介在して出来たもの（カバーレイ本貼りプレス工程、打ち抜きプレス工程）

【原因、判断要点、发生工序】覆盖层压合或者冲切时夹杂杂物所引起的（覆盖层压合工序、冲切工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

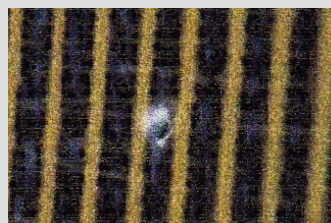
The defect is caused by the presence of a foreign object in a coverlay application or blanking process (Coverlay application or blanking process)



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×

7-4-30 FPC 補強板下気泡残り／FPC 增强板下吸附气泡／Bubble under FPC stiffener

【特徴】FPCの補強板の下に気泡が認められ白っぽく見える状態の欠陥

【特征】FPC 增强板下有偏白色气泡的缺陷。